

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	开源证券、海通证券、MassAve Global
时间	2022年7月1日、2022年7月28日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 欧新华；董事、副总经理 陈敏；董事、财务总监、董事会秘书 兰芳云；高级产品经理 戴维；证券事务代表 闵雨琦；证券事务专员 江璐璐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问答环节：</p> <p>一、请问公司如何看待手机等消费类电子行业的景气度下降的情况？</p> <p>尽管受到疫情等因素的影响导致消费类电子行业景气度有所下降，但整个市场仍存在较大的需求和发展空间，公司通过持续研发投入，开发迭代新的技术平台，不断推出高性能的产品，来满足客户的应用要求，并逐步实现国产替代，公司非常有信心通过产品优势来不断增大在消费电子行业的市场占比。同时，公司将通过研发投入，不断加快在其他领域的产品布局，如新能源，汽车等领域。</p> <p>二、公司在收并购方面的主要方向是？</p> <p>围绕公司战略发展方向，公司将积极寻求与公司技术、产品、业务等协同性好的优质标的资产，充分调研并审慎选择。一方面，在产业链上下游纵向拓展，偏向上游以保障产能供应。另一方面，在器件或电源 IC 等方向横向发展，拓宽产品能力。后续如有相关事项，请留意公司在指定法定信息</p>

披露媒体披露的公告内容。

三、公司功率器件和功率 IC 产品的分配？

公司以功率器件产品为基础，保持稳步增长，以功率 IC 产品为主要增长点，实现迅速增长。公司根据客户需求，将功率器件与功率 IC 产品有效结合，提供具体竞争力的整体解决方案。

四、公司第三代半导体产品的研发进度如何？

公司在第三代半导体产品研发方面，前期重点研发 GaN，目前 GaN 已经成功推出几款产品，正在客户处进行验证、测试；今年重点进行 SiC 的肖特基的相关研发工作，SiC 的肖特基产品已经产出样品，目前处于工程验证阶段，另外，SiC 的 MOS 产品也处于研发阶段。

公司致力于为客户提供第三代半导体 GaN HEMT 器件和相关配套 IC 解决方案。公司的 GaN 产品将逐步向市场推广，由于目前 GaN 器件的成本中，外延片成本占整个流片成本的一半，未来公司将开发自有的 GaN 外延片来控制芯片成本，同时优化外延良率，形成公司核心技术。另外在应用层面，公司产品丰富，可利用现有 SGT MOS、TVS、TMBS、电源管理 IC 等产品和 GAN 器件进行搭配，形成整体的解决方案，可缩短客户的研发周期，并具有较好性价比。

五、请问公司未来战略布局？

公司产品可应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域，公司将持续研发高性能产品，不断进行产品的更新迭代及产品结构优化，在继续深耕消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域的时候，公司也在积极将产品延伸到其他领域，在汽车、新能源等领域积极拓展。

目前，公司车规级 TVS 产品正在国产电动汽车头部厂家进行验证导入。另公司还在积极开发中高压 MOSFET、Super Junction MOSFET 等产品，以及第三代半导体 GaN 和

SiC 产品，目前 GaN 已经成功推出几款产品，在客户处进行验证、测试；1200V 高压 SiC 肖特基产品已经开发出产品，目前处于工程验证阶段。

六、未来 2-3 年公司复合增速最快的业务在哪里？

2021 年度，公司功率 IC 产品量价齐升，营业收入同比增长 62.29%；功率器件产品稳步增长，营业收入同比增长 27.27%，产销率 99.77%，销售量同比增长 21.17%。公司重点产品表现优异，其中 TVS 销售额 30,313.44 万元，同比增长 17.23%，MOSFET 产品销售额 7,237.71 万元，同比增长 81.99%。

预计未来 2-3 年，MOS 及功率 IC 相关产品是一个公司的一个重要增长点，同时新应用领域的扩展也是公司未来增长的驱动力。

七、公司 ESD 保护器件的竞争优势是什么？

公司的 ESD 保护器件主要以高性能，低功耗，小型化的产品为主，尤其是采用 DFN1006,DFN0603 小尺寸封装形式的这类 ESD 产品，泄放电流大，漏电低，电容低，公司通过技术平台的升级，不断优化迭代 ESD 产品的性能，使得公司的产品在市场上具有很大的性能优势。如采用 SCR 结构的具有深回退特性的 ESD 产品，对后级电路据有更好的保护效果，如公司推出的超低电容的 ESD 产品，电容小于 0.15pf，在不影响高速信号线（如 5G 通信，USB3.1 等）的信号传输情况下，实现有效的静电保护，目前公司部分产品关键性能指标达到或优于国际、国内竞品水平。

八、公司是否有股权激励方面的计划？

公司高度重视人才队伍建设，在符合国家政策法规的前提下，公司会在合适的时机考虑对骨干人才实施股权激励，进一步调动核心骨干人才创新创业的积极性，助力公司高质量发展，若有股权激励方案落地实施，公司将会按规定履行

	信息披露义务。
附件清单（如有）	
日期	2022年7月